

中雷pcb阻抗板灯板铝基板电镀镍金板 沉头孔板 手机盲埋孔板

产品名称	中雷pcb阻抗板灯板铝基板电镀镍金板 沉头孔板 手机盲埋孔板
公司名称	东莞市中雷电子有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:中雷 型号:ZL 产地:东莞
公司地址	长安镇乌沙新安工业区睦邻路7号
联系电话	15158938985

产品详情

pcb电路板制作流程 中雷电子

印制线路板的设计工艺流程包括原理图的设计、电子元器件数据库登录、设计准备、区块划分、电子元器件配置、配置确认、布线和最终检验。在流程过程中，无论在哪道工序上发现了问题，都必须返回到上道工序，进行重新确认或修正。

1,根据电路功能需要设计原理图。原理图的设计主要是依据各元器件的电气性能根据需要进行合理的搭建，通过该图能够准确的反映出该PCB电路板的重要功能，以及各个部件之间的关系。原理图的设计是PCB制作流程中的第一步，也是十分重要的一步。通常设计电路原理图采用的软件是PROTEL。

2,原理图设计完成后，需要更近一步通过PROTEL对各个元器件进行封装，以生成和实现元器件具有相同外观和尺寸的网格。元件封装修改完毕后,要执行Edit/Set Preference/pin
1设置封装参考点在第一引脚.然后还要执行Report/Component Rule check
设置齐全要检查的规则,并OK.至此,封装建立完毕。

3,正式生成PCB。网络生成以后，就需要根据PCB面板的大小来放置各个元件的位置，在放置时需要确保各个元件的引线不交叉。放置元器件完成后，最后进行DRC检查，以排除各个元器件在布线时的引脚或引线交叉错误，当所有的错误排除后，一个完整的pcb设计过程完成。

4,利用专门的复写纸张将设计完成的PCB图通过喷墨打印机打印输出，然后将印有电路图的一面与铜板相对压紧，最后放到热交换器上进行热印，通过在高温下将复写纸上的电路图墨迹粘到铜板上。

5,制板。调制溶液，将硫酸和过氧化氢按3：1进行调制，然后将含有墨迹的铜板放入其中，等三至四分钟左右，等铜板上除墨迹以外的地方全部被腐蚀之后，将铜板取去，然后将清水将溶液冲洗掉。

6,打孔。利用凿孔机将铜板上需要留孔的地方进行打孔，完成后将各个匹配的元器件从铜板的背面将两个或多个引脚引入，然后利用焊接工具将元器件焊接到铜板上。

7,焊接工作完成后，对整个电路板进行全面的测试工作，如果在测试过程中出现问题，就需要通过第一步设计的原理图来确定问题的位置，然后重新进行焊接或者更换元器件。当测试顺利通过后，整个电路板就制作完成了。